3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年10月６日から令和５年11月８日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を導入説明書交付後別途開催する。
⑴　開催日時　令和５年10月18日14時00分
⑵　開催場所　国立研究開発法人産業技術総合研究所　つくばセンターつくば中央事業所１群　共用講堂２階　大会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 71, 27
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : AI Bridging Cloud Infrastructure for developing real-world foundation models 1 Set
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement : AI Bridging Cloud Infrastructure for developing real-world foundation models, hereinafter called “Shin-ABCI”, consists of ⑴ High Performance Computing System, ⑵ Large Capacity Storage System, ⑶ Interconnects for Computation, Service, and External connection, and ⑷ advanced cooling and power supplies, and ⑸ software stacks for utilizing the system to the maximum. The followings are the summary of the requirements for the specification of Shin-ABCI :
A．High Performance Computing System must have more than 4.2 E AI-FLOPS of theoretical peak performance in at least half precision of IEEE 754—2008 floating point.
B．High Performance Computing System must have high-speed memory directly connected to acceleration processors, where the total memory capacity is more than 345TB, and the total peak memory bandwidth is more than 14.4PB／s.
C．Large Capacity Storage System must have more than 50PB of total effective capacity with scalable, high speed, high reliability performance and the standard access interface. The storage system must be available to all compute nodes of High Performance Computing System.
D．Interconnect for Computation must connect High Performance Computing System and Large Capacity Storage System with more than 400Gbps. Bisection bandwidth of the network must be as higher as possible. Effective bandwidths between compute nodes and between compute nodes and Large Capacity Storage System must have more than 400Gbps.
E．Interconnect for Service must connect High Performance Computing System, Large Capacity Storage System, and External Connection.
F．Shin-ABCI must have advanced cooling and power supplies enough to operate at less than 5,000kW of maximum power consumption.
G．Shin-ABCI must have software stacks for making the optimal use of the system for advanced cloud operations, acceleration and enhancement of AI computations, and utilization of Big Data.
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 17 : 00, November 15, 2023
⑹　Contact point for the notice : INABA Fuminori and HIBINO Daichi, Procurement Division, High-value Procurement Office, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1—1—1 Umezono, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305—8560 Japan. TEL 029—850—5195

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和５年10月６日
国立大学法人京都大学長　湊　　長博

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26
○第５号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　15、28
⑵　導入計画物品及び数量　学術情報ネットワークシステムスイッチ　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度12月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　館内スイッチ
⑻　ＩＥＥＥ802.3aeに基づく10ＧＢＡＳＥ－Ｒの回線インターフェースを12ポート以上備えるＬ２スイッチであること。
⑹　ＩＥＥＥ802.1Ｑに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。
⑽　スタック機能及び電源冗長化機能を有すること。
B　末端スイッチ　１Gbps　24ポートタイプ
⑻　ＩＥＥＥ802.3zに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｘの回線インターフェース２ポート以上、ならびにＩＥＥＥ802.3abに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｔの回線インターフェース24ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。
⑹　ＩＥＥＥ802.1Ｑに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。
C　末端スイッチ　１Gbps　48ポートタイプ
⑻　ＩＥＥＥ802.3zに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｘの回線インターフェース２ポート以上、ならびにＩＥＥＥ802.3abに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｔの回線インターフェース48ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。
⑹　ＩＥＥＥ802.1Ｑに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。
D　末端スイッチ　10Gbps　24ポートタイプ
⑻　ＩＥＥＥ802.3aeに基づく10ＧＢＡＳＥ－Ｒの回線インターフェース２ポート以上、ならびにＩＥＥＥ802.3abに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｔの回線インターフェース24ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。
⑹　ＩＥＥＥ802.1Ｑに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。
E　末端スイッチ　10Gbps　48ポートタイプ
⑻　ＩＥＥＥ802.3aeに基づく10ＧＢＡＳＥ－Ｒの回線インターフェース２ポート以上、ならびにＩＥＥＥ802.3abに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｔの回線インターフェース48ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。
⑹　ＩＥＥＥ802.1Ｑに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。
F　末端スイッチ　１Gbps　24ポートＰｏＥタイプ
⑻　ＩＥＥＥ802.3aeに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｘの回線インターフェース２ポート以上、ならびにＩＥＥＥ802.3abに基づく1000ＢＡＳＥ－Ｔの回線インターフェース24ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。
⑹　ＩＥＥＥ802.1Ｑに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。
⑽　ＩＥＥＥ802.3afまたはＩＥＥＥ802.3atに基づくＰｏＥ機能を12ポート以上有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和５年11月６日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒606—8507 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学医学部附属病院経理・調達課　契約掛長　田井　睦之　電話075—751—3025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年10月６日から令和５年11月６日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和５年10月11日10時00分
⑵　開催場所　京都大学医学部附属病院外来診療棟５階会議室Ｂ
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。